

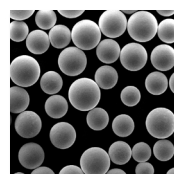


Welco AP520 水溶性 SAC305 T6 和 T7 焊锡膏

Welco AP520 是一款先进的水洗型锡膏，可提供 T6 和 T7 粉径。AP520 专门为 SIP 应用中的无源器件和倒装芯片的贴装而设计的。具有出色的脱模表现，无飞溅，在长时间的作业寿时间内空洞率最小。

主要优势

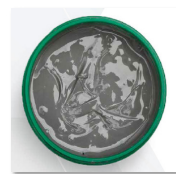
- 超低空洞率
- 无飞溅或锡珠
- 用高品质 Welco 焊粉
- 仅用 DI 水即可清洗掉
- 在 55um 钢网开口 (T7) 和 90um 钢网开口 (T6) 下保持一致的锡膏释放



Welco 锡粉



助焊剂体系



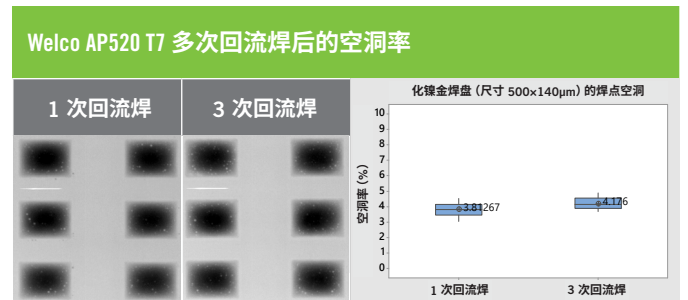
Welco AP520
焊锡膏

| Welco AP520 T7 在钢网上使用寿命的连续性印刷测试 | 0H | 4H | 8H | 12H |
|---------------------------------|----|----|----|-----|
| 方形开孔 | | | | |
| 环形开孔 | | | | |

- 钢网开孔 = 55 μm; 开孔间距 = 35 μm, 钢网厚度 = 25 μm, 面积比: 0.55; 化镍金表面
- 连续印刷 12 小时未观察到遗漏点或桥连缺陷

| Welco AP520 T7 008004 无源器件贴装连续印刷时间和印刷后作业时间 | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 0H | 12H | 12H+8H STG+CA | 12H+CA 8H STG |
| | | | |
| | | | |

- 连续印刷 12 小时和印刷后作业 8 小时未观察到立碑、锡珠或桥连缺陷
- 总空洞率低于 10%



- 3 次回流焊后 AP520 仍然展现出稳定的低空洞率

一体化印制方案



优点:

- 工序更少
- 消除了助焊剂成本和基板预敷焊料成本
- 大幅降低冷焊或焊点不完整缺陷

美洲
电话 +1 610 825 6050
electronics.americas@heraeus.com

亚太区
电话 +65 6571 7649
electronics.apac@heraeus.com

中国
电话 +86 53 5815 9601
electronics.china@heraeus.com

欧洲、中东和非洲
电话 +49 6181 35 4370
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本(可索要最新版本文件)。尽管数据均准确无误,但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任(除非事先以协议的形式征得明确的书面同意)。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识、贺利氏、Heraeus 和 Welco 图形商标均为贺利氏集团或其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。